

EA3560JA12-33.333M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

REGULATORY COMPLIANCE (Data Sheet downloaded on Jun 21, 2020)


[Click badges to download compliance docs](#)

Regulatory Compliance standards are subject to updates by governing bodies. Click the badges to download the latest compliance docs for this part number directly from Ecliptek.



ITEM DESCRIPTION

Quartz Crystal Resonator 3.5mm x 6.0mm x 1.0mm 4 Pad Ceramic Surface Mount (SMD) 33.333MHz ± 15 ppm at 25°C, ± 30 ppm over -40°C to +85°C 12pF Parallel Resonant

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Nominal Frequency	33.333MHz
Frequency Tolerance/Stability	± 15 ppm at 25°C, ± 30 ppm over -40°C to +85°C
Aging at 25°C	± 3 ppm/year Maximum
Load Capacitance	12pF Parallel Resonant
Shunt Capacitance	5pF Maximum
Equivalent Series Resistance	50 Ohms Maximum
Mode of Operation	AT-Cut Fundamental
Drive Level	100 μ Watts Maximum
Spurious Response	-3dB Minimum (Measured from Fo to Fo +5000ppm)
Storage Temperature Range	-40°C to +85°C
Insulation Resistance	500 Megaohms Minimum (Measured at 100Vdc)

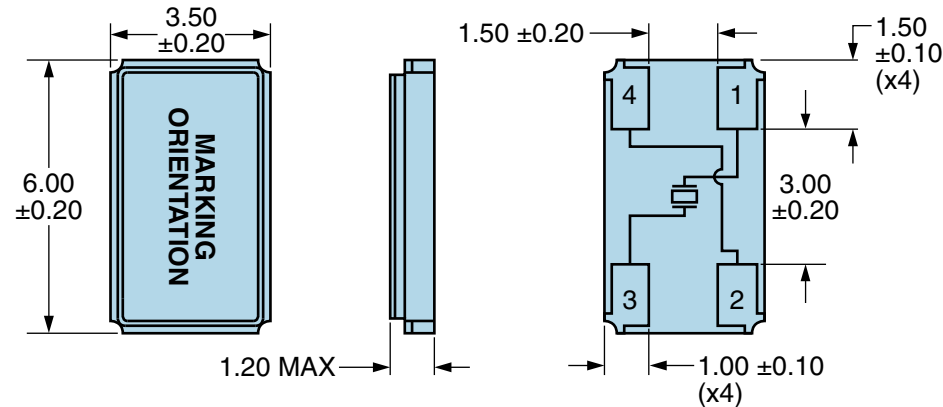
ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS

ESD Susceptibility	MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V
Fine Leak Test	MIL-STD-883, Method 1014, Condition A
Flammability	UL94-V0
Gross Leak Test	MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
Mechanical Shock	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Moisture Resistance	MIL-STD-883, Method 1004
Moisture Sensitivity	J-STD-020, MSL 1
Resistance to Soldering Heat	MIL-STD-202, Method 210, Condition K
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Method 215
Solderability	MIL-STD-883, Method 2003
Temperature Cycling	MIL-STD-883, Method 1010, Condition B
Vibration	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

EA3560JA12-33.333M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)



Note: Chamfer not shown.

PIN	CONNECTION
1	Crystal
2	Case/Ground
3	Crystal
4	Case/Ground

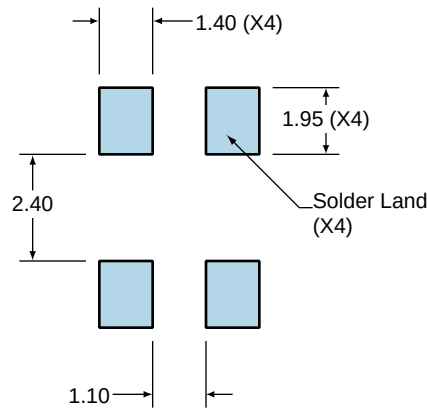
LINE	MARKING
1	E33.33 E=Ecliptek Designator
2	XXXXXX XXXXXX=Ecliptek Manufacturing Identifier

Seam Sealed

Terminal Plating Thickness: Gold (0.3 to 1.0µm) over Nickel (1.27 to 8.89µm).

Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters



All Tolerances are ±0.1

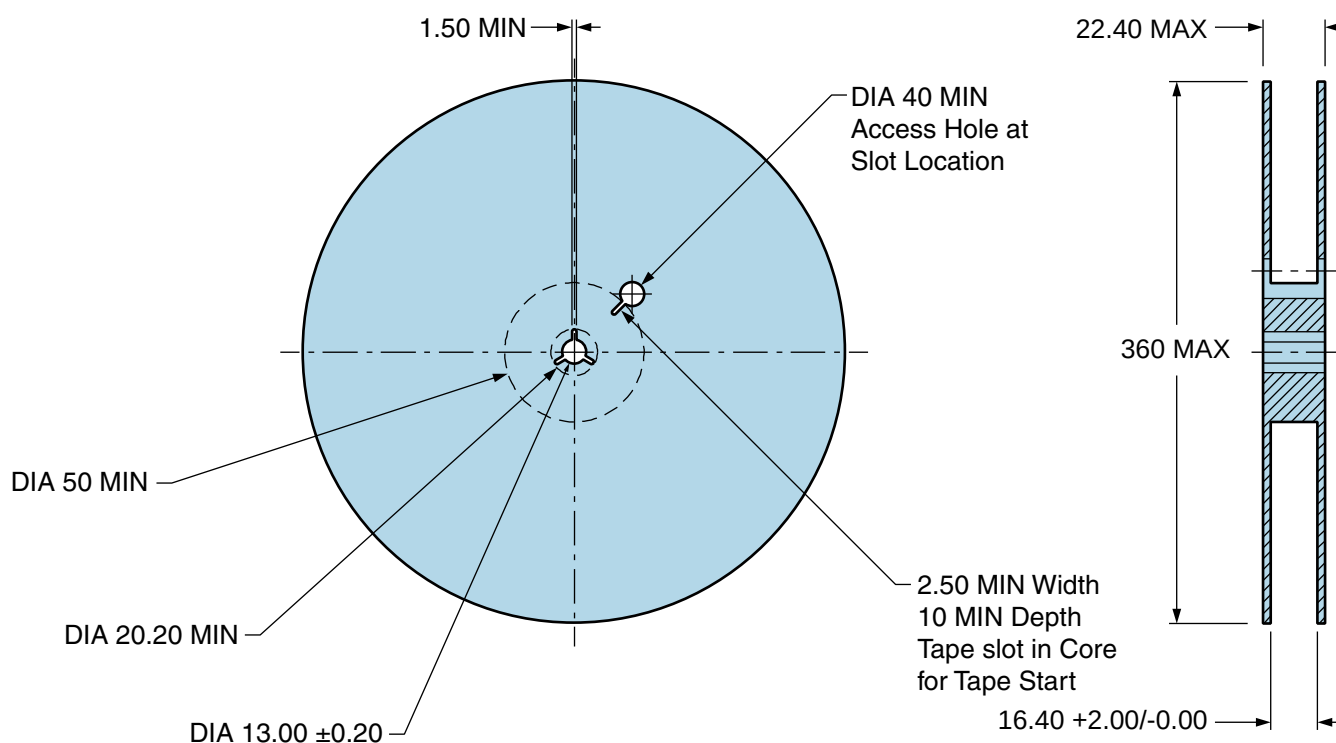
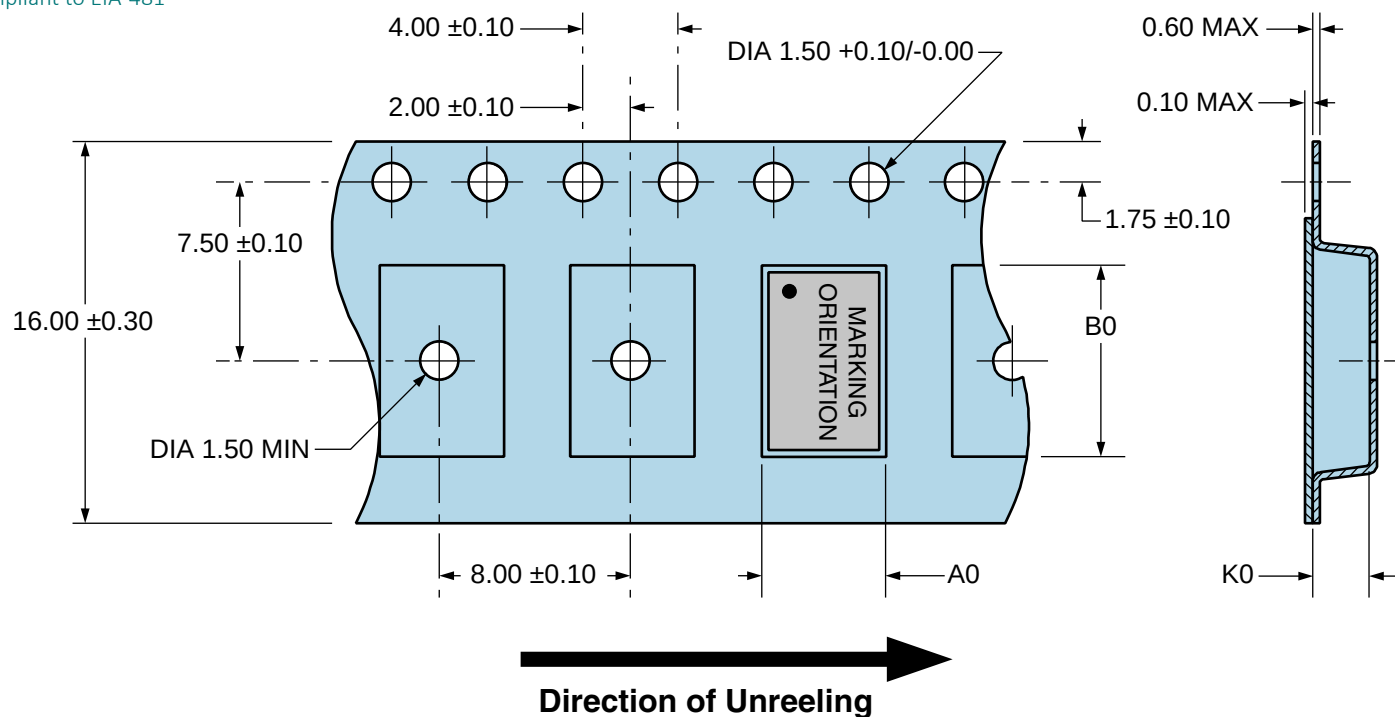
EA3560JA12-33.333M TR

Tape & Reel Dimensions

Quantity Per Reel: 1,000 units

All Dimensions in Millimeters

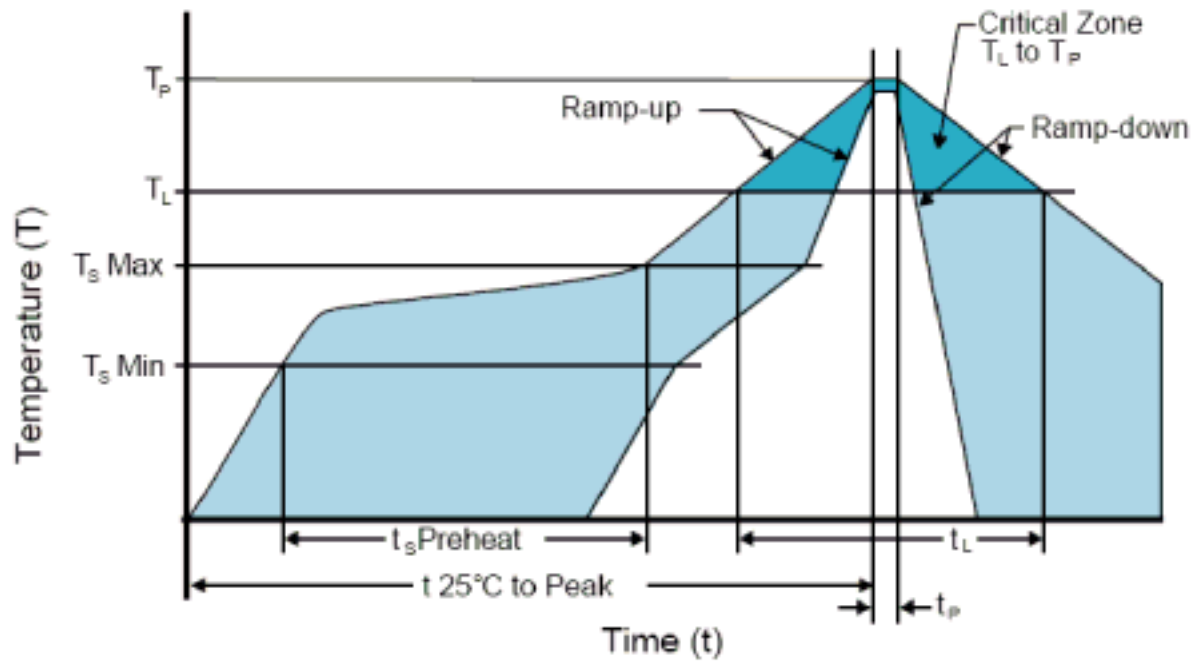
Compliant to EIA-481



EA3560JA12-33.333M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

Recommended Solder Reflow Methods



High Temperature Infrared/Convection

Ts MAX to TL (Ramp-up Rate)	3°C/Second Maximum
Preheat	
- Temperature Minimum (Ts MIN)	150°C
- Temperature Typical (Ts TYP)	175°C
- Temperature Maximum (Ts MAX)	200°C
- Time (ts MIN)	60 - 180 Seconds
Ramp-up Rate (TL to TP)	3°C/Second Maximum
Time Maintained Above:	
- Temperature (TL)	217°C
- Time (tL)	60 - 150 Seconds
Peak Temperature (TP)	260°C Maximum for 10 Seconds Maximum
Target Peak Temperature (TP Target)	250°C +0/-5°C
Time within 5°C of actual peak (tp)	20 - 40 Seconds
Ramp-down Rate	6°C/Second Maximum
Time 25°C to Peak Temperature (t)	8 Minutes Maximum
Moisture Sensitivity Level	Level 1
Additional Notes	Temperatures shown are applied to body of device.

EA3560JA12-33.333M TR

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

Recommended Solder Reflow Methods



Low Temperature Infrared/Convection 245°C

TS MAX to TL (Ramp-up Rate)	5°C/Second Maximum
Preheat	
- Temperature Minimum (TS MIN)	N/A
- Temperature Typical (TS TYP)	150°C
- Temperature Maximum (TS MAX)	N/A
- Time (ts MIN)	30 - 60 Seconds
Ramp-up Rate (TL to TP)	5°C/Second Maximum
Time Maintained Above:	
- Temperature (TL)	150°C
- Time (tL)	200 Seconds Maximum
Peak Temperature (TP)	245°C Maximum
Target Peak Temperature (TP Target)	245°C Maximum 2 Times / 230°C Maximum 1 Time
Time within 5°C of actual peak (tP)	10 Seconds Maximum 2 Times / 80 Seconds Maximum 1 Time
Ramp-down Rate	5°C/Second Maximum
Time 25°C to Peak Temperature (t)	N/A
Moisture Sensitivity Level	Level 1
Additional Notes	Temperatures shown are applied to body of device.

Low Temperature Manual Soldering

185°C Maximum for 10 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

High Temperature Manual Soldering

260°C Maximum for 5 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[EA3560JA12-33.333M TR](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331